

低温硬化性ベンゾオキサジンモノマー

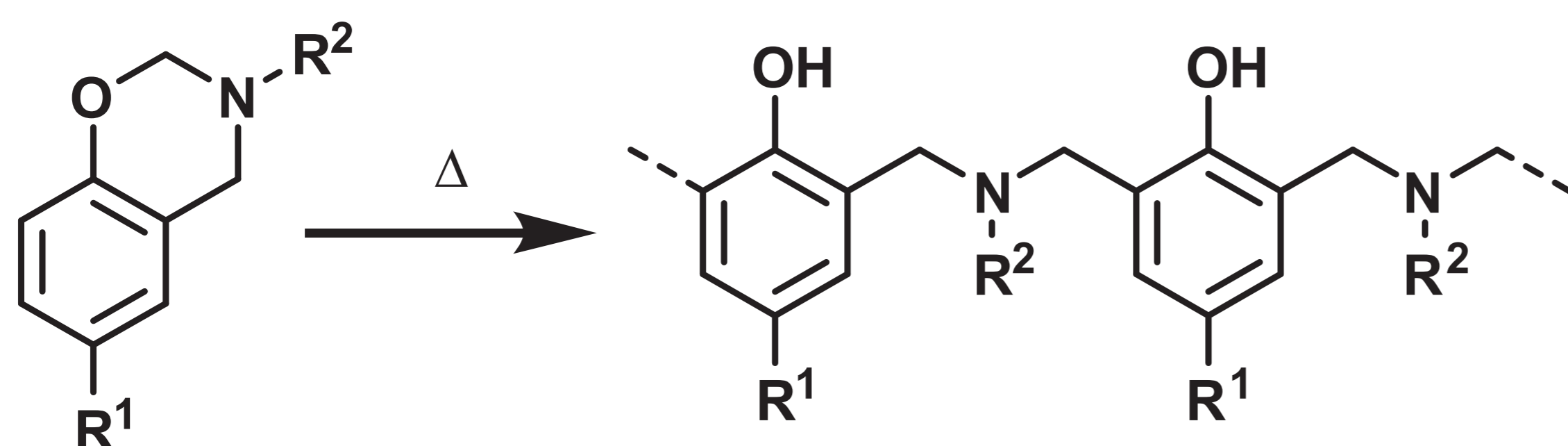
開発品

Benzoxazine Monomer with Low Temperature Curable

低温硬化性、高耐熱性、低粘度を目指したベンゾオキサジンモノマーを開発しています。

We are developing Benzoxazine(BOZ) monomers with keywords of low-temperature curability, high heat resistance, and low-viscosity.

製品紹介 Product introduction



低温硬化
low-temperature curability

高耐熱性
high heat resistance

低粘度
low-viscosity

- 低温硬化性、耐熱性、低粘度などの特性をバランスよく兼ね備えております。

Our BOZ monomers have low-temperature curability, high heat resistance and low viscosity.

- ビスマレイミド (BMI) やエポキシとの配合により、高耐熱性樹脂が得られます。(図1参照)

By blending our BOZ with BMI or epoxy, it is also possible to enhance the resin Tg more.

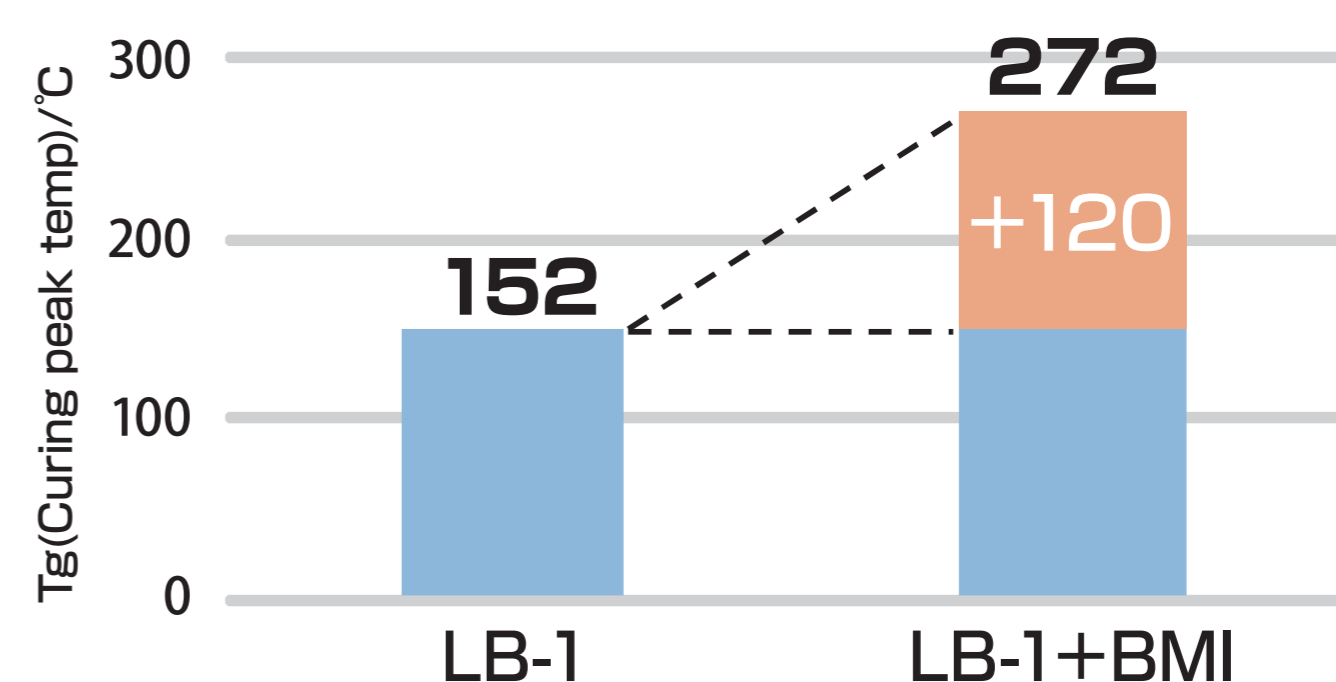


図1. BMIとの配合による相乗効果 (LB-1での実績例)
The high heat resistance of LB-1 by mixing BMI

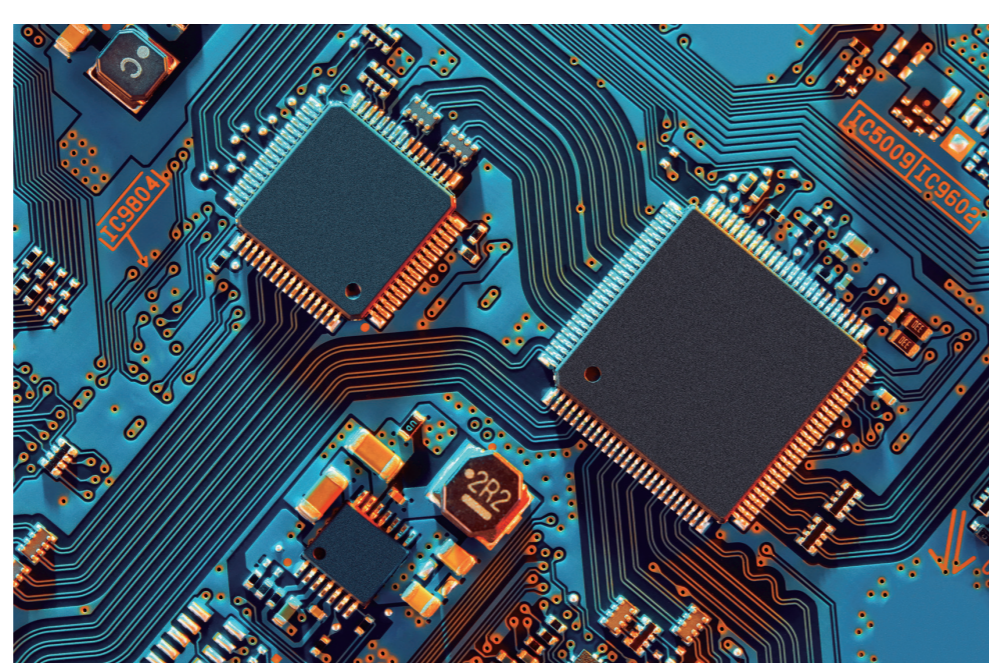
製品名 Product name	一般的な BOZモノマー the conventional BOZ monomer	LA-1	LB-1	LB-2	LB-3	LB-4
硬化発熱温度 Curing peak temp.	230	227	187	193	220	224
Tg/°C Glass transition temp.	222	243	152	209	188	—
粘度/Pa·S Viscosity	11.9	1.9	3.3	—	—	—

低温硬化 low-temperature curability

高耐熱性
high heat resistance

低粘度 low-viscosity

用途例 Possible application



半導体封止材
MOLDING COMPOUNDS



接着剤
ADHESIVES